

請求の範囲

- [請求項1] 成形用の樹脂シートであって、
デュポン衝撃試験における衝撃強度が1.0 J以上であり、
引張試験で得られる応力ひずみ曲線において、原点から破断したときのひずみまでを積分した値が80 N/m²以下である、樹脂シート。
- [請求項2] ポリカーボネート樹脂及びABS樹脂のうちの少なくとも一種を含有する、請求項1に記載の樹脂シート。
- [請求項3] 基材層と、該基材層の少なくとも一方の面に積層された表面層と、を備え、
前記基材層が、ポリカーボネート樹脂及びABS樹脂のうちの少なくとも一種と、無機フィラーと、を含み、
前記表面層が、ポリカーボネート樹脂及びABS樹脂のうちの少なくとも一種と、導電性材料と、を含む、請求項1に記載の樹脂シート。
- [請求項4] 前記基材層における前記無機フィラーの含有量が、前記基材層全量を基準として、0.3～28質量%である、請求項3に記載の樹脂シート。
- [請求項5] 前記無機フィラーの平均一次粒径が10 nm～5.0 μmである、請求項3又は4に記載の樹脂シート。
- [請求項6] 前記基材層が、前記無機フィラーとしてカーボンブラックを含む、請求項3～5のいずれか一項に記載の樹脂シート。
- [請求項7] 前記表面層における前記導電性材料の含有量が、前記表面層全量を基準として、10～30質量%である、請求項3～6のいずれか一項に記載の樹脂シート。
- [請求項8] 前記基材層の厚みが、樹脂シート全体の厚みに対して70～97%である、請求項3～7のいずれか一項に記載の樹脂シート。
- [請求項9] 請求項1～8のいずれか一項に記載の樹脂シートの成形体である、

容器。

- [請求項10] 請求項 1 ～ 8 のいずれか一項に記載の樹脂シートの成形体であって、物品を収容できる収容部が設けられている、キャリアテープ。
- [請求項11] 請求項 1 0 に記載のキャリアテープと、前記キャリアテープの前記収容部に収容された電子部品と、蓋材として前記キャリアテープに接着されたカバーフィルムと、を備える、電子部品包装体。